

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 6700/89 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr. : 6700/89 (51) Int. Cl. 5: A 23 G 3/30
(22) Indleveringsdag:.... 28 dec 1989
(24) Løbedag:..... 28 dec 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 30 jun 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr. :... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 29 dec 1988 US 291707
(71) Ansøger: *Warner-Lambert Company, 201 Tabor Road; Morris Plains; New Jersey 07950, US
(72) Opfinder: Subraman Rao *Cherukuri, 10 Jean Drive; Towaco; New Jersey 07082, US
Gul *Mansukhani, 97 Petrus Avenue; Island; New York 10312, US
Tommy Limkwong *Chau, 3 Dartmouth Avenue #3A; Bridgewater; New Jersey 08807, US
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., H. C. Andersens Boulevard 4, 1553, København V

-
- (54) Vandfrit tyggegummimateriale samt dættets fremstilling
(57) Sammendrag

6700-89

Tyggematerialer, der er modstandsdygtige mod optagelse af fugtighed og hærkning og har et fugtighedsindhold på mindre end ca. 1 vægt-%, fortrinsvis mindre end ca. 0,3 vægt-% af det færdige materiale, omfatter en hård eller en blød gummibase, smagsgivende middel, sødemiddel samt et hydrofobt blødgøringsmiddel. Dette tyggegummimateriale kan fremstilles uden afkøling og kræver ingen konditionering forud for indpakning. Forud for indpakningen kan tyggegummistykkerne overtrækkes med et sødemiddel på kendt måde ved omgivelsernes temperature og ved op til 80% relativ fugtighed.